

Title (en)

Apparatus for cutting laminate floor panels

Title (de)

Vorrichtung zum Schneiden von Laminat-Fußbodenplatten

Title (fr)

Dispositif de coupe de plaques de plancher laminées

Publication

EP 2636494 A2 20130911 (DE)

Application

EP 13158871 A 20100216

Priority

- DE 102009003490 A 20090216
- EP 10704558 A 20100216

Abstract (en)

The device has a cutting blade (6) fastened to a frame (2) to swivel about a swivel axis formed by a swivel bearing. A cutting edge (7) of the blade plunges into a plunge slit (4) when the blade is swiveled from an open position to a closed position. A cutting point (8) lying in a swivel plane between a support (3) and the cutting edge moves from a proximal side of the support with respect to the bearing to a distal side of the support with respect to the bearing when the blade is closed. The bearing is relocated in an extension direction of the slit.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Schneiden einer porösen, im Wesentlichen biegesteifen Platte (1), insbesondere Laminat-Fußbodenplatte mit einem Gestell (2), einer vom Gestell (2) gebildeten Auflage (3) für die Platte (1), einen der Auflage (3) zugeordneten Eintauchschlitz (4) und einem am Gestell (2) um eine von einem Schwenklager (5, 9) gebildeten Schwenkachse (A) schwenkbar derart befestigten Schneidmesser (6), dass dessen Schneidkante (7) beim Schwenken des Schneidmessers (6) von einer Offenstellung in eine Geschlossenstellung in den Eintauchschlitz (4) eintaucht, wobei ein in der Schwenkebene liegender Schnittpunkt (8) zwischen Auflage (3) und Schneidkante (7) während des Schließens des Schneidmessers (6) von der zum Schwenklager (5, 9) proximalen Seite der Auflage (3) hin zu der zum Schwenklager (5, 9) distalen Seite der Auflage (3) wandert. Erfindungsgemäß besitzt das Schneidmesser (6) eine sich zwischen der Brust (6') und dem Rücken (6'') des Schneidmessers (6) querschnittsverminderte Zone (68), die in der Offenstellung des Schneidmessers im Bereich der Auflage (3) und insbesondere parallel dazu verläuft.

IPC 8 full level

B23D 17/08 (2006.01); **B26D 1/30** (2006.01); **B26D 7/01** (2006.01)

CPC (source: EP)

B26D 1/30 (2013.01); **B26D 7/01** (2013.01); **E04F 21/0076** (2013.01); **B26D 5/02** (2013.01); **B26D 5/10** (2013.01); **B26D 7/00** (2013.01); **E04F 21/00** (2013.01)

Citation (applicant)

- FR 575749 A 19240805
- FR 612747 A 19261029
- FR 847014 A 19391002

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR

DOCDB simple family (publication)

DE 102009003490 A1 20100819; DE 202010018003 U1 20130912; EP 2396151 A2 20111221; EP 2396151 B1 20130529; EP 2617538 A1 20130724; EP 2617538 B1 20140702; EP 2617538 B2 20211208; EP 2636494 A2 20130911; EP 2636494 A3 20131204; EP 2636494 B1 20150318; ES 2491819 T3 20140908; ES 2491819 T5 20220411; ES 2535383 T3 20150508; WO 2010092183 A2 20100819; WO 2010092183 A3 20101223

DOCDB simple family (application)

DE 102009003490 A 20090216; DE 202010018003 U 20100216; EP 10704558 A 20100216; EP 13158871 A 20100216; EP 13164222 A 20100216; EP 2010051919 W 20100216; ES 13158871 T 20100216; ES 13164222 T 20100216